

Puls-Magnetron-Sputtern

Beschichtung von Bauteilen und Werkzeugen

Technologien

Das Puls-Magnetron-Sputtern (PMS) ist unsere Kernkompetenz bei der Entwicklung und Anwendung spezieller Vakuum-Beschichtungstechnologien, die auf der Nutzung von Magnetron-Gasentladungen unter gepulster Zufuhr von elektrischer Energie mit Frequenzen von 10 ... 100 kHz basieren. Dies ermöglicht die effiziente Herstellung neuartiger Schichten bei hohen Abscheideraten. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Entwicklung komplexer integrierter Prozesstechnologien und Know-how-Pakete (IP), die folgende Bereiche abdecken:

- Entwicklung und Fertigung von PMS-Schlüsselkomponenten
- Entwicklung von PMS-Prozessen
- Entwicklung von Schichtsystemen
- Kombinationsprozesse mit Elektronenstrahlverdampfung und plasmagestützter CVD
- Sputter-Quellen und PMS-Prozesse
- Anlagentechnik und Know-how für Produktionsanlagen

Anwendungen

- Harte, verschleißfeste Beschichtungen auf Werkzeugen, insbesondere für die Hochgeschwindigkeitszerspannung
- Neue superharte Werkstoffe für spezielle Anwendungen (Nanokomposite)
- Schichten für den Korrosionsschutz von Bauteilen
- Beschichtung von Massengütern (Verbindungselemente für Autos und Flugzeuge etc.)
- Dekorative Beschichtungen auf dreidimensionalen Teilen aus Metall, Glas und Kunststoff
- Tribologische Beschichtungen
- Funktionelle Schichten für die Medizintechnik (biokompatible und bioaktive Schichten auf Ti-Basis)
- Barrierschichten

Kontakt

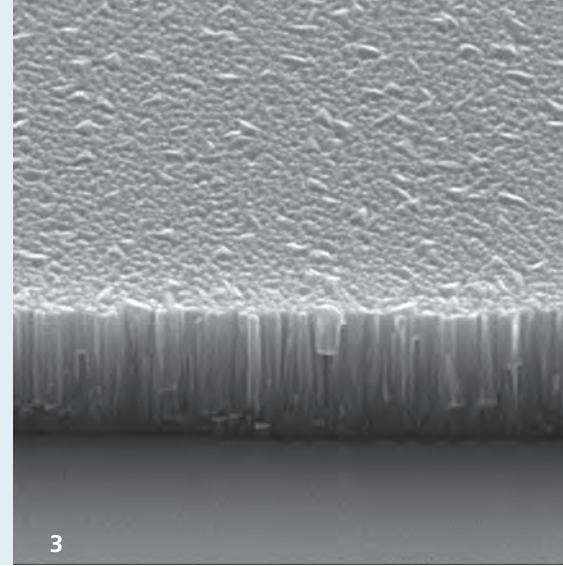
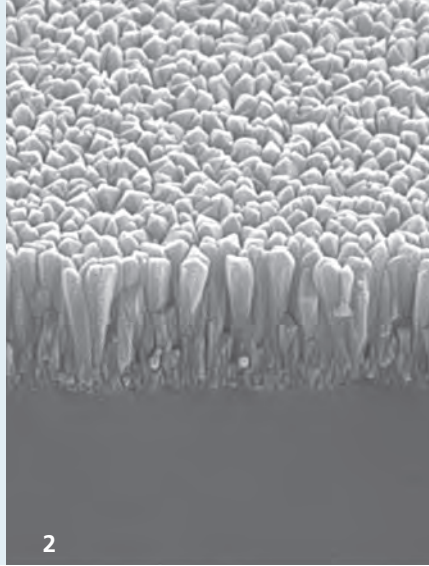
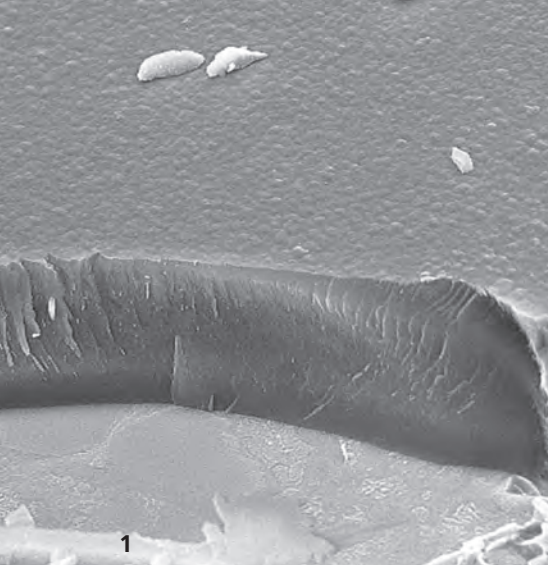
Dr. Fred Fietzke
Telefon +49 351 2586-366
fred.fietzke@fep.fraunhofer.de

Dr. Heidrun Klostermann
Telefon +49 351 2586-367
heidrun.klostermann@fep.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP

Winterbergstr. 28
01277 Dresden

www.fep.fraunhofer.de



Schichten

Eine große Vielfalt an:

- Metallen und Legierungen
- Verbindungen wie Oxide, Nitride, Carbide von Al, Cr, Ti, Zr, Mo, W, ...
- Gradientenschichten
- Mehrlagenschichten
- Schichten mit maßgeschneiderter Struktur (amorph – kristallin – Komposit)
- Barrierschichten

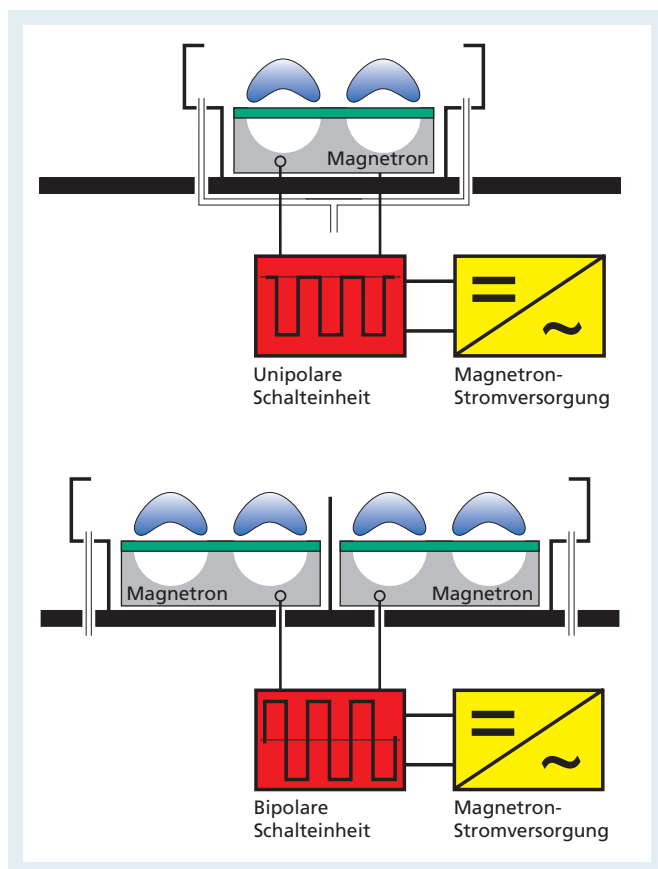
Technische Spezifikationen

Sputtern

Plasmavorbehandlung

Prozesskontrolle

- DC-Sputtern
- Unipolar gepulstes Sputtern
- Bipolar gepulstes Sputtern
- HiPIMS
- DC-Ätzen
- Puls-Plasma-Vorbehandlung
- Hohlkathoden-unterstütztes Ätzen
- Optische Plasma-Emission
- Partialdruck
- Entladungswiderstand



Prinzip des unipolar und bipolar gepulsten Magnetronsputters

- 1 Al_2O_3 , 4,6 μm , kristalline γ -Phase, Korngröße 15 nm, verschleißfest
- 2 TiO_2 , 1,3 μm , Anatasphase, Korngröße 200 nm, photokatalytisch
- 3 AlN , 1,4 μm , Wurtzitphase, Korngröße 70 nm, piezoelektrisch